

※ 108 學年起申請本微學分學程者適用

學分學程名稱：行動應用與數位互動微學程			學程代碼： 總學分數為 12 學分 K45			
類別	中文科目名稱	英文科目名稱	課程代碼	開課系所	備註	
必修課程	行動App程式設計	Mobile App Programming	C0T0224442	軟創學程	隨班附讀	二選一
	行動軟體設計與開發	Mobile Application Development	C0T0322367	軟創學程	隨班附讀下學期	
	互動控制程式設計	Interactive Control Programming	C0T0224443 D510324443	軟創學程	隨班附讀下學期	三選一
	多媒體互動設計	Interactive Media Design	C0T0220622	軟創學程	隨班附讀下學期	
	互動媒體概論	Introduction to Interactive Media	D510217602	資工系	隨班附讀下學期	
	3D列印電腦輔助設計	Computer Aided Design	C0T0224439	軟創學程	隨班附讀上學期	二選一
	3D列印電腦輔助製造	Computer Aided Manufacturing	C0T0224440	軟創學程	隨班附讀下學期	
	創意設計思考與方法	Creative Thinking Techniques	C0T0120294	軟創學程	隨班附讀上學期	
	專題(一)	Research Project (I)	D510309029A	資工系	隨班附讀下學期	三選一
	專題(二)	Research (II)	C0T0309374A	軟創學程	隨班附讀下學期	
	專題(一)	Research Project (I)	C0T0309029A	軟創學程	隨班附讀上學期	

備註：開課資訊一切以當學年度網路系統公告為主

第一學期	第二學期
行動APP程式設計 (3學分)	互動控制程式設計 (3學分)
行動軟體設計與開發 (3學分)	多媒體互動設計 (3學分)
3D列印電腦輔助設計 (3學分)	互動媒體概論 (3學分)
3D列印電腦輔助製造 (3學分)	專題(一) (1學分)
創意設計思考與方法 (2學分)	專題(二) (2學分)
專題(一) (1學分)	

軟創學程  
 資工系